证券代码:301629　　证券简称:矽电股份　　公告编号:2026-006

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以41,727,274股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.54元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

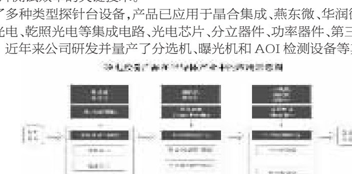
股票简称	矽电股份	股票代码	301629
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨波	陈裕强、伍艳丽	
办公地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三楼东区、五楼中西区	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三楼东区、五楼中西区	
传真	0755-89724107	0755-89724107	
电话	0755-84534618	0755-84534618	
电子信箱	ir@sidea.com.cn	ir@sidea.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务基本情况

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,系国内领先的探针台制造企业。探针测试技术主要应用于半导体制造晶圆检测(CP,Circuit Probing)环节,也应用于全流程晶圆接受测试(WAT测试,Wafer Acceptance Test)、设计验证和成品测试(FT,Final Test)环节,是检测芯片性能与缺陷,保证芯片测试准确性,提高芯片测试效率的关键技术。

公司自主研发了多种类型探针台设备,产品已应用于晶合集成、燕东微、华润微、卓胜微、士兰微、华天科技、华灿光电、聚灿光电、乾照光电等集成电路、光电芯片、分立器件、功率器件、第三代化合物半导体等国内半导体龙头企业产线。近年来公司研发并量产了分选机、曝光机和AOI检测设备等其他半导体专用设备。



2、主要产品基本情况

(1)探针台

①晶圆探针台

晶圆探针台是对未切割晶圆上的器件进行特性或故障检测而使用的测试设备,主要应用在集成电路、功率器件、分立器件等领域。公司是中国大陆首家实现产业化应用的12英寸晶圆探针台设备厂商,同时也是国内产品覆盖最广的晶圆探针台设备厂商。

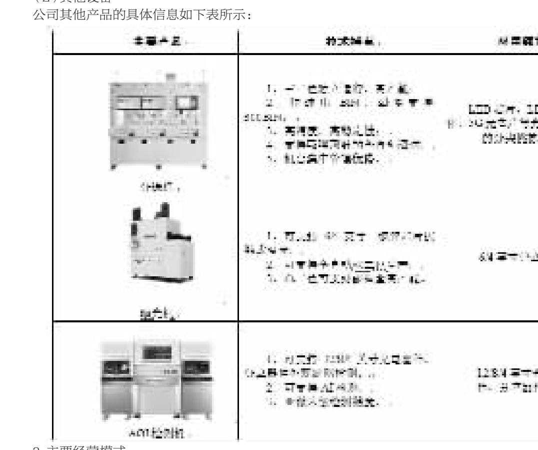
②晶粒探针台

晶粒探针台是对晶圆划片后的裸晶粒进行检测的探针测试设备,公司晶粒探针台已达到行业领先水平。公司晶粒探针台适用于4-6英寸PD、APD、LED等光电芯片的自动测试,具有滤光片自动切换等自主研发的技术。公司晶粒探针台通过选取自制电流源或其他电流源,形成探针测试一体机。

公司探针台产品的具体信息如下表所示:

(2)其他设备

公司其他产品的具体信息如下表所示:



3、主要经营模式

(1)研发模式

公司主要采取自主研发的模式,拥有核心技术的自主知识产权。公司设置有研发中心,确保公司技术研发活动规范有序开展。公司根据客户需求、半导体专用设备技术动态为导向,聚焦探针测试技术及相关的半导体测试设备技术的研发。公司已建成完善的技术研发体系,公司的技术研发流程主要分为立项阶段、实施阶段、验证阶段和结案阶段四个环节,公司研发模式具有评审委员会审批、项目负责人组织牵头、多部门联合验证测试的特点。

(2)采购模式

公司对供应商进行评估,通过评估后纳入合格供应商体系,同一原材料的供应商通常选择两至三家作为备选。公司采购的原材料主要包括电气类、机加类、机械类和其他类等物料。公司采购主要为直接采购,少量通过代理商采购。公司经询价及议价后采取与合格供应商签订年度框架合同或订单的形式开展采购。采购部门根据公司各部门的采购需求信息,综合考虑原材料库存、生产安排、订单情况等,采购部门在合格供应商中安排具体采购。采购物品到货后,由品质部门负责质量检验,经检验合格后验收入库,完成采购。

(3)生产模式

公司主要根据客户订单安排生产,少部分产品备货式生产。生产环节公司采用自主生产和外协定制相结合的生产模式。公司自身专注于生产计划安排、物料需求分派、定制加工管控、精密装配、精度校准、软件烧录、精度及效率检测、老化检验等核心生产步骤。机械零部件、电子元器件(如PCBA)等零部件主要采用外协定制加工完成生产,公司向外协定制厂商制定并提供定制加工部件所必要的材质要求、设计参数、设计图纸、原材料、质量标准等,由外协定制厂商完成加工。在产品质量控制环节,公司基于ISO9001:2015质量管理体系,运用品质管理工具,对产品和生产工艺进行持续优化和生产监控,确保产品的一致性和可靠性。

(4)营销及销售模式

公司采取直销的销售模式,存在少量代销情况。直销模式下,公司通过与潜在客户商务谈判或通过招投标等方式获取订单,在客户开发新产品、规划生产线的前期就与客户沟通以获取需求信息,经过多轮沟通,公司研发和设计出满足客户需求的探针台设备。目前公司销售人员主要依托深圳总部和无锡分公司进行市场开拓、服务客户,随着业务规模的逐渐扩大、客户分布区域的逐渐广泛,公司将会建立更多贴近客户的办事处,以即时响应客户需求、提供售后服务。

公司与特定代理商签订产品代理协议,由其负责在境外特定地区客户和国内部分客户代理销售相关产品,公司仅针对少量客户采取代销模式。

4、主要业绩驱动因素

(1)技术进步及产品更新迭代推动需求扩张

现阶段,半导体器件正朝着更高集成度和更大尺寸晶圆发展。随着半导体生产工艺进步,市场对高精度、大行程探针台设备的需求持续提高。此外,下游半导体厂商的新工艺迭代也驱动半导体设备的同步更新。目前,半导体行业整体景气度推动新材料、新工艺、新制程频繁迭代,进而也持续催生对探针台设备更新换代的新需求。

(2)半导体产业转移带来的半导体设备国产化替代

中国大陆连续多年成为全球最大的半导体消费市场,根据SEMI数据,2024年中国大陆半导体设备销售额496亿美元。然而与我国快速增长的半导体产业不相匹配的是,我国大量核心半导体设备长期依赖进口。近年来,国际政治环境的变化导致我国半导体供应链存在严重的安全问题。因此,在供应链安全日渐成为国内半导体厂商关注焦点后,本土半导体设备制造业迎来了前所未有的发展契机,未来的市场空间广阔。

(3)国家政策支持

半导体产业是国民经济中基础性、关键性和战略性的产业,国家为扶持集成电路行业发展,制定了多项支持政策,持续出台了多项政策,从保护集成电路知识产权、税收鼓励、投融资、目标规划方面,将集成电路装备列为国家科技重大专项,多维度鼓励支持半导体行业发展,这些政策为半导体产业发展突破瓶颈提供了保障。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	1,391,808,766.67	1,005,278,602.42	38.45%	982,126,782.29
归属于上市公司股东的净资产	1,193,009,868.64	716,951,277.38	66.40%	624,860,733.77
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	418,847,439.78	507,810,820.98	-17.52%	546,369,486.53
归属于上市公司股东的净利润	52,827,814.03	91,868,196.81	-42.50%	89,216,577.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,857,457.16	87,364,402.36	-44.08%	83,155,945.58
经营活动产生的现金流量净额	1,504,326.16	15,244,387.62	-90.13%	-78,864,917.75
基本每股收益(元/股)	1.35	2.94	-54.08%	2.85
稀释每股收益(元/股)	1.35	2.94	-54.08%	2.85
加权平均净资产收益率	4.95%	13.69%	-8.74%	15.30%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,366,957.65	89,236,746.04	107,245,516.21	129,998,219.88
归属于上市公司股东的净利润	11,504,343.53	9,851,776.17	3,706,056.04	27,765,638.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,200,402.59	9,362,996.94	2,463,703.61	26,830,354.02
经营活动产生的现金流量净额	-1,800,175.86	-23,918,331.83	-38,899,023.95	66,121,857.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,206	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
何沁修	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0.00
王胜利	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0.00
杨波	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0.00
辜国文	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0.00
胡泓	境内自然人	9.16%	3,824,236.00	3,824,236.00	不适用	0.00
深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.17%	2,158,122.00	2,158,122.00	不适用	0.00
深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙)-吉安市西博壹号自控创投合伙企业(有限合伙)	其他	4.55%	1,896,806.00	1,896,806.00	不适用	0.00
宁波丰年荣通投资管理有限公司-宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.11%	1,716,524.00	1,716,524.00	不适用	0.00
深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	1,251,818.00	1,251,818.00	不适用	0.00
醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.82%	1,175,224.00	1,175,224.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓分别于2017年9月及2021年8月签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》,其五人为一致行动关系。深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓,其五人共合计持有深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)12.12%的权益。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

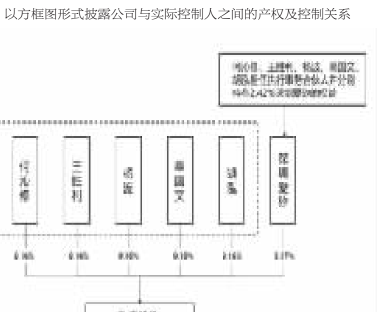
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:301629　　证券简称:矽电股份　　公告编号:2026-010

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月20日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润为52,827,814.03元,母公司实现净利润90,501,336.12元。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,提取盈余公积5,215,909.50元后,截至2025年12月31日,公司合并报表累计未分配利润为394,448,379.03元;母公司累计未分配利润为375,555,032.53元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至2025年12月31日,公司可供股东分配利润为375,555,032.53元。

鉴于公司盈利状况良好,结合公司未来发展前景和战略规划,为积极回报广大投资者,与所有股东分享公司发展经营成果,并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,公司拟定2025年度利润分配预案如下:

以现有的总股本41,727,274.00股为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币2.54元(含税),不送红股,不以公积金转增资本,合计分配现金股利人民币10,598,727.60元,占2025年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的20.06%。

在分配预案披露后至实施期间,公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的,将按照现金分红总额固定不变的原则,相应调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

(下转286版)

证券代码:301629　　证券简称:矽电股份　　公告编号:2026-008

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	31,380,326.81	92,366,957.65	-66.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,398,831.64	11,504,343.53	-190.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,879,852.94	10,200,402.59	-216.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,285,075.35	-1,800,175.86	-2,082.29%
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.37	-167.57%
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.37	-167.57%
加权平均净资产收益率	-0.88%	1.59%	-2.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,413,833,587.23	1,391,808,766.67	1.58%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,182,611,037.00	1,193,009,868.64	-0.87%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,665.82	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	903,477.80	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	861,411.27	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,439.26	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	149,131.04	其他
减:所得税影响额	263,590.56	
少数股东权益影响额(税后)	10,303.17	
合计	1,481,021.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用□不适用

主要为代扣代缴个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

项目	本期期末	上期年末	变动比率	变动说明
预付款项	9,464,165.93	4,248,596.36	122.76%	主要系报告期内采购备料预付款增加所致
应收款项融资	28,914,825.11	19,208,252.34	50.53%	主要系报告期内收到信用级别较高的银行承兑增加所致
其他流动资产	13,249,603.18	5,700,405.38	132.43%	主要系报告期内销售出库开票的销项税金增加所致
使用权资产	8,732,945.96	1,148,530.53	660.36%	主要系报告期内租赁合同到期重签后确认得使用权资产所致
递延所得税资产	17,411,065.33	13,163,765.88	32.27%	主要系报告期内亏损确认递延所得税资产增加所致
应付账款	59,831,389.50	33,371,109.90	79.29%	主要系报告期内采购额增加所致
合同负债	75,562,871.55	49,476,009.76	52.73%	主要系报告期内预收账款增加所致
应付职工薪酬	8,266,814.55	15,173,167.88	-45.52%	主要系上报告期末计提奖金于本期发放所致
一年内到期的非流动负债	3,113,070.50	414,054.47	651.85%	主要系报告期内租赁合同到期重签后一年内到期的租赁负债增加所致
租赁负债	5,723,208.12	772,704.98	640.67%	主要系报告期内租赁合同到期重签后确认租赁负债增加所致
少数股东权益	-956,913.89	-528,098.68	-81.20%	主要系报告期内子公司亏损所致

2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动说明
一、营业收入	31,380,326.81	92,366,957.65	-66.03%	主要系报告期内设备验收金额下降所致
减:营业成本	21,628,610.55	59,724,405.16	-63.79%	主要系报告期内设备验收金额下降所致
销售费用	6,021,402.54	4,105,880.64	46.65%	主要系报告期内扩大业务覆盖,人员增加,薪酬增加所致
加:其他收益	1,962,909.08	3,502,214.05	-43.95%	主要系报告期内软件退税金额同比减少所致
投资收益(损失以"-"号填列)	1,590,411.27	149,993.61	960.32%	主要系报告期内现金管理理财收益同比增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-208,936.84	-1,391,712.25	84.99%	主要系报告期内存货跌价计提金额减少所致
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,682,353.26	10,994,124.69	-233.55%	主要系报告期内设备验收金额下降所致
加:营业外收入	-11,155.45	754,561.24	-101.48%	主要系上年报告期有大额应付核销,本报告期无大额应付核销
减:营业外支出	147,949.63	34,194.91	332.67%	主要系报告期内有对高校捐赠支出所致
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,841,458.34	11,714,491.02	-226.69%	主要系报告期内设备验收金额下降所致
减:所得税费用	-4,013,811.49	92,288.22	-4449.21%	主要系报告期内亏损确认递延所得税资产所致
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,827,646.85	11,622,202.80	-193.16%	主要系报告期内设备验收金额下降所致
归属于母公司所有者的净利润	-10,398,831.64	11,504,343.53	-190.39%	主要系报告期内设备验收金额下降所致
少数股东损益	-428,815.21	117,859.27	-463.84%	主要系报告期子公司亏损增加所致

3、现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-39,285,075.35	-1,800,175.86	-2082.29%	主要系报告期内销售收款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	12,465,274.32	-200,904.00	6304.59%	主要系报告期内募投资金及自有资金现金管理增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-904,262.29	497,270,443.04	-100.18%	主要系上期IPO募集资金,本报告期无重大股权融资所致
五、现金及现金等价物净增加额	-27,724,063.32	495,269,363.18	-105.60%	主要系上期IPO募集资金,本报告期无重大股权融资所致
六、期末现金及现金等价物余额	221,227,852.23	759,039,997.69	-70.85%	主要系报告期内现金管理资金未到期所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
辜国文	境内自然人	9.16%	3,824,236	3,824,236	不适用	0
王胜利	境内自然人	9.16%	3,824,236	3,824,236	不适用	0
胡泓	境内自然人	9.16%	3,824,236	3,824,236	不适用	0
杨波	境内自然人	9.16%	3,824,236	3,824,236	不适用	0
何沁修	境内自然人	9.16%	3,824,236	3,824,236	不适用	0
深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.17%	2,158,122	2,158,122	不适用	0
深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙)-吉安市西博壹号自控创投合伙企业(有限合伙)	其他	4.55%	1,896,806	0	不适用	0
宁波丰年荣通投资管理有限公司-宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙)	其他	4.11%	1,716,524	0	不适用	0
深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	1,251,818	1,251,818	不适用	0
醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.82%	1,175,224	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙)-吉安市西博壹号自控创投合伙企业(有限合伙)	1,896,806	人民币普通股	1,896,806
宁波丰年荣通投资管理有限公司-宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业(有限合伙)	1,716,524	人民币普通股	1,716,524
醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,175,224	人民币普通股	1,175,224
深圳市西博创新投资有限公司-吉安市西博汇鑫贰号创业投资合伙企业(有限合伙)	1,082,466	人民币普通股	1,082,466
宁波丰年景顺投资管理有限公司-成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)	757,740	人民币普通股	757,740
深圳市西博创新投资有限公司-吉安市西博汇鑫三号创投合伙企业(有限合伙)	618,532	人民币普通股	618,532
顾乡	545,455	人民币普通股	545,455
林志强	333,700	人民币普通股	333,700
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	284,700	人民币普通股	284,700
国信证券股份有限公司	246,136	人民币普通股	246,136
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓分别于2017年9月及2021年8月签署了《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》,其五人为一致行动关系。深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓,其五人共合计持有深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)12.12%的权益。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

(三)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
辜国文	3,824,236	0	0	3,824,236	首发前限售股	2028年3月24日
王胜利	3,824,236	0	0	3,824,236	首发前限售股	2028年3月24日
胡泓	3,824,236	0	0	3,824,236	首发前限售股	2028年3月24日
杨波	3,824,236	0	0	3,824,236	首发前限售股	2028年3月24日
何沁修	3,824,236	0	0	3,824,236	首发前限售股	2028年3月24日
深圳市爱矽电子装备合伙企业(有限合伙)	2,158,122	0	0	2,158,122	首发前限售股	2028年3月24日
深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙)-吉安市西博壹号自控创投合伙企业(有限合伙)	1,896,806	1,896,806	0	0	首发前限售股	2026年3月24日
宁波丰年荣通投资管理有限公司-宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业(有限合伙)	1,716,524	1,716,524	0	0	首发前限售股	2026年3月24日
深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)	1,251,818	0	0	1,251,818	首发前限售股	2028年3月24日
醴陵众微创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,175,224	1,175,224	0	0	首发前限售股	2026年3月24日
深圳市西博创新投资有限公司-吉安市西博汇鑫贰号创业投资合伙企业(有限合伙)	1,082,466	1,082,466	0	0	首发前限售股	2026年3月24日
宁波丰年景顺投资管理有限公司-成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业(有限合伙)	757,740	757,740	0	0	首发前限售股	2026年3月24日
林志强	750,000	750,000	0	0	首发前限售股	2026年3月24日
深圳市西博创新投资有限公司-吉安市西博汇鑫三号创投合伙企业(有限合伙)	618,532	618,532	0	0	首发前限售股	2026年3月24日
顾乡	545,455	545,455	0	0	首发前限售股	2026年3月24日
深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙)-吉安市西博聚鑫贰号创业投资合伙企业(有限合伙)	221,588	221,588	0	0	首发前限售股	2026年3月24日
赵英	100	0	0	100	高管锁定股	2026年5月28日
合计	31,295,555	8,764,335	0	22,531,220	--	--

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:矽电半导体设备(深圳)股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	241,531,016.61	278,871,452.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	303,000,000.00	316,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	32,407,259.27	33,780,590.38
应收账款	150,216,804.35	159,324,755.54
应收款项融资	28,914,825.11	19,208,252.34
预付款项	9,464,165.93	4,248,596.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,042,645.96	2,558,476.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	331,288,574.82	284,738,955.84
其中:数据资源		
合同资产	11,462,904.25	13,729,137.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,091,744.64	32,159,942.54
其他流动资产	13,249,603.18	5,700,405.38
流动资产合计	1,158,669,544.12	1,150,320,565.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	47,515,796.39	46,712,275.63
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,161,298.74	1,216,049.79
固定资产	10,782,132.05	10,889,591.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,732,945.96	1,148,530.53
无形资产	2,431,958.34	2,701,138.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,140,568.30	2,264,107.78
递延所得税资产	17,411,065.33	13,163,765.88
其他非流动资产	164,988,278.00	163,392,742.53
非流动资产合计	255,164,043.11	241,488,201.38
资产总计	1,413,833,587.23	1,391,808,766.67
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,432,928.34	76,295,705.35
应付账款	59,831,389.50	33,371,109.90
预收款项		
合同负债	75,562,871.55	49,476,009.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,266,814.55	15,173,167.88
应交税费	1,018,191.43	1,156,618.11
其他应付款	2,795,675.52	2,514,513.24
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,113,070.50	414,054.47
其他流动负债	13,061,036.73	14,446,753.49
流动负债合计	221,081,978.12	192,847,932.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,723,208.12	772,704.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,252,328.32	2,632,360.64
递延收益	2,888,461.58	3,073,998.89
递延所得税负债	233,487.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,097,486.00	6,479,064.51
负债合计	232,179,464.12	199,326,996.71
所有者权益:		
股本	41,727,274.00	41,727,274.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	735,970,578.61	735,970,578.61
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,863,637.00	20,863,637.00
一般风险准备		
未分配利润	384,049,547.39	394,448,379.03
归属于母公司所有者权益合计	1,182,611,037.00	1,193,009,868.64
少数股东权益	-956,913.89	-528,098.68
所有者权益合计	1,181,654,123.11	1,192,481,769.96
负债和所有者权益总计	1,413,833,587.23	1,391,808,766.67

法定代表人:何沁修　主管会计工作负责人:付亚芬　会计机构负责人:付亚芬

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	31,380,326.81	92,366,957.65
其中:营业收入	31,380,326.81	92,366,957.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,370,764.95	82,387,173.45
其中:营业成本	21,628,610.55	59,724,405.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	260,348.32	369,669.22
销售费用	6,021,402.54	4,105,880.64
管理费用	4,884,007.15	4,560,997.26
研发费用	16,343,452.95	14,690,279.28
财务费用	-767,056.56	-1,064,058.11
其中:利息费用	110,908.37	45,465.19
利息收入	893,790.00	1,126,212.39
加:其他收益	1,962,909.08	3,502,214.05
投资收益(损失以"-"号填列)	1,590,411.27	149,993.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,036,298.63	-1,246,154.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-208,936.84	-1,391,712.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-14,682,353.26	10,994,124.69
加:营业外收入	-11,155.45	754,561.24
减:营业外支出	147,949.63	34,194.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-14,841,458.34	11,714,491.02
减:所得税费用	-4,013,811.49	92,288.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,827,646.85	11,622,202.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-10,398,831.64	11,504,343.53
2.少数股东损益	-428,815.21	117,859.27
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,827,646.85	11,622,202.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,398,831.64	11,504,343.53
归属于少数股东的综合收益总额	-428,815.21	117,859.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.25	0.37
(二)稀释每股收益	-0.25	0.37

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:何沁修　主管会计工作负责人:付亚芬　会计机构负责人:付亚芬

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,411,317.97	71,620,185.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	433,384.57	2,578,250.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,549,408.02	2,649,946.72
经营活动现金流入小计	49,394,110.56	76,848,382.10
购买商品、接受劳务支付的现金	47,054,189.71	34,215,303.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,527,516.78	32,319,645.76
支付的各项税费	1,896,089.52	5,964,530.43
支付其他与经营活动有关的现金	4,201,389.90	6,149,078.07
经营活动现金流出小计	88,679,185.91	78,648,557.96
经营活动产生的现金流量净额	-39,285,075.35	-1,800,175.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	295,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	861,411.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	295,861,441.27	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,396,166.95	200,904.00
投资支付的现金	282,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	283,396,166.95	200,904.00
投资活动产生的现金流量净额	12,465,274.32	-200,904.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		501,575,497.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		501,575,497.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	904,262.29	4,305,054.28
筹资活动现金流出小计	904,262.29	4,305,054.28
筹资活动产生的现金流量净额	-904,262.29	497,270,443.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,724,063.32	495,269,363.18
加:期初现金及现金等价物余额	248,951,915.55	263,770,634.51
六、期末现金及现金等价物余额	221,227,852.23	759,039,997.69

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司董事会

2026年4月22日